IC封裝 / 測試工程師

職務定義

進行新產品導入封裝製程評估、設備操作，並對封裝廠製程良率控管及製程端異常及問題分析

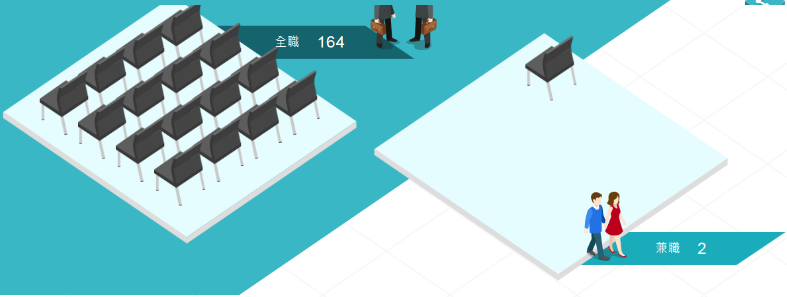
工作內容

1. 做IC晶圓測試，晶片電性功能測是使IC進入封裝前能先行過濾出電性功能不良的晶片以降低IC成品不良率
2. 將加工完成之晶圓晶切割後之晶粒以塑膠、陶磁、金屬等材料被覆，以達保護晶粒避免受到外界污染及易於裝配應用，並達到晶片與電子系統間之電性連接、實體支撐及散熱之效果
3. IC成品測試，確認成品功能、速度、容忍度、電力消耗等屬性是否正常，確保出貨品質
4. 相關技術支援，測試、封裝過程記錄與資料分析
5. 產品開發

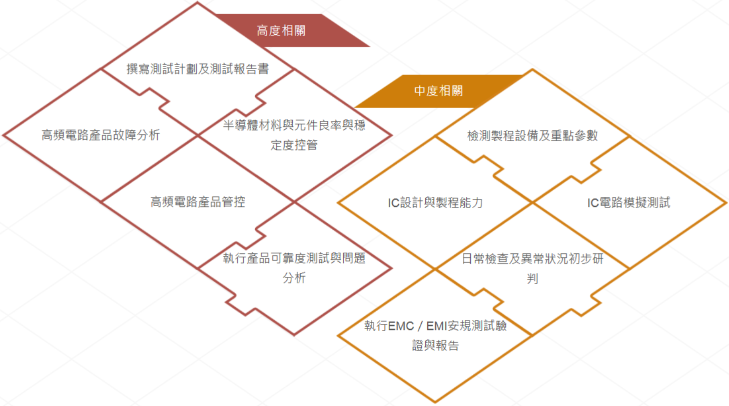
相似職務

測試工程師、晶圓/成品測試工程師、IC Testing Engineer、封裝製程工程師

意見反應



關鍵職能



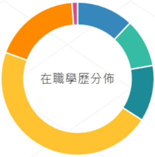
高度相關

- 撰寫測試計劃及測試報告書
- 高頻電路產品故障分析
- 半導體材料與元件良率與穩定度控管
- 高頻電路產品管控
- 執行產品可靠度測試與問題分析

中度相關

- 檢測製程設備及重點參數
- IC設計與製程能力
- IC電路模擬測試
- 日常檢查及異常狀況初步研判
- 執行EMC / EMI安規測試驗證與報告

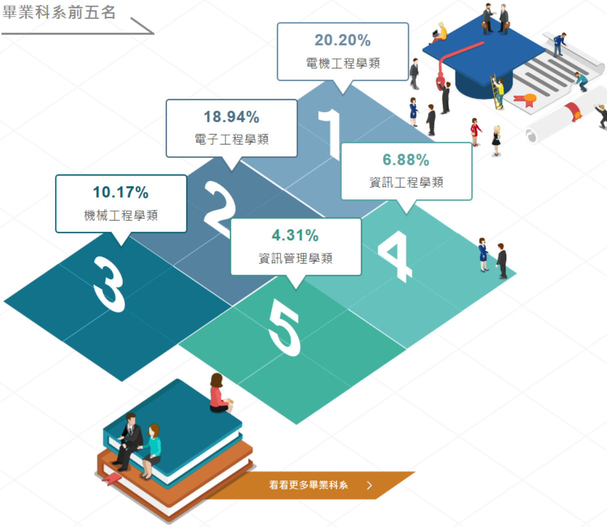
學歷分佈



● 高中職	11.97%
● 專科	10.17%
● 公立大學	11.81%
● 私立大學	46.29%
● 研究所	18.17%
● 博士	1.16%

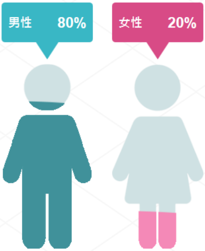
IC封裝 / 測試工程師 有
77.42%具備大學以上學歷

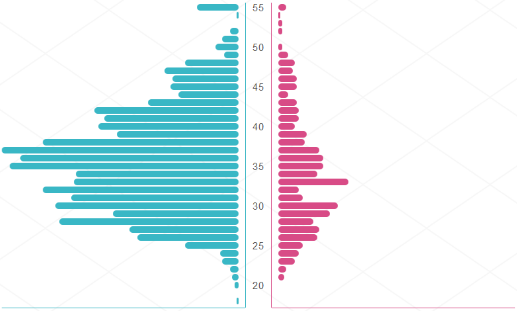
畢業科系前五名



看看更多畢業科系 ›

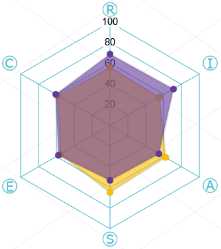
性別年齡





IC封裝 / 測試工程師 以年紀較長男性居多

職涯類型



R - 實作型　I - 研究型　A - 藝術型　S - 社交型　E - 企業型　C - 常規型

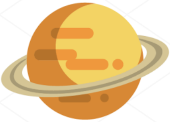
🟡 不分職務(全體)的六型分數　🟣 該職務的六型分數

興趣類型

前往Holland興趣測驗瞭解 >

研究型 Investigative　實做型 Realistic　常規型 Conventional

IC封裝 / 測試工程師在研究型的分數最高，這類型的人樂於觀察、思考、分析，喜歡用頭腦依自己的步調解決問題並追根究底。做事時能提出新的想法和策略，但通常對實際解決問題的細節較無興趣，喜歡和有相同興趣或專業的人討論，或者自己看書思考。



九大職能類型

前往九大職能星測驗瞭解 >

土星 Saturn(應用型)

偏向使用專業知識進行應用與統整或分析的活動。

職務能力

各產業職能需求

不分行業

1. Specialty DRAM KGD 產品驗證/測試程式開發
2. 工程品分析及測試程式驗證
3. 因應客戶新產品或程式導入及修改電路
4. 低良率/異常品分析
5. 協助生產線異常問題排除
6. 協助客戶工程師處理 routine 及工程事項
7. 為客戶開發新程式
8. 產品電性分析 、測試良率改善
9. 晶圓包裝材料評估、驗證及BOM建立
10. 進行良率改善，異常事件解析
11. 開發DRAM FT(Final test)程式及特性分析程式
12. 新式導線架/基板開發評估
13. 新型IC構裝技術之引進及驗証
14. 新產品封裝可靠性測試驗証
15. 新產品訊號編寫及不良品電性分析
16. 新產品導入量產驗證及製程改善
17. 新機台、測試平台評估
18. 督導異常處置及規劃改善方案
19. 維護DRAM FT(Final test)程式和工程分析程式

專業證照

相關證照

前往證照中心 ›

- 高考電機工程技師
- 乙級油壓技術士
- 丙級電力電子技術士
- 機械工程師基礎能力鑑定
- LPIC Level 1
- 乙級精密機械工程技術士
- 乙級電腦輔助機械製圖技術士
- 丙級視聽電子技術士
- 丙級工業儀器技術士

一 薪資行情

平均薪資

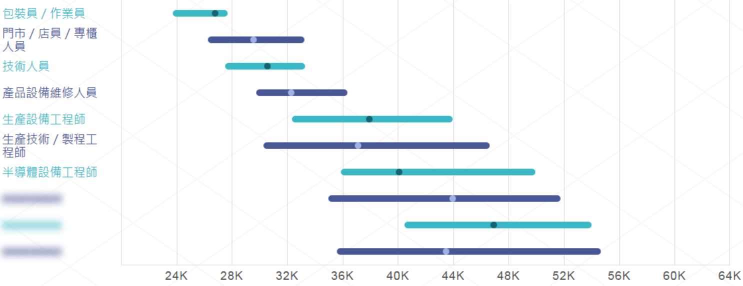
前往薪資公秤 ›

NT$35,575	1年以下平均
NT$39,531	1~3年平均
NT$43,248	3~5年平均
NT$50,317	5~7年平均
NT$54,652	7~9年平均

高中職(含以下)	NT$29,951
專科	NT$33,751
大學	NT$34,581
研究所	NT$39,248
博士	NT$41,191

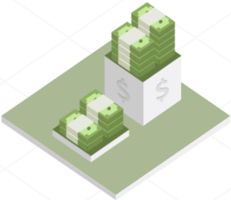
相關職務薪資比較

更多相關職缺 ›



登入會員即可查看薪資比較前3名

未來發展

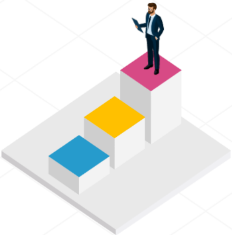


下一份工作平均薪資提升

15.80%

跳下一份工作平均時間

30個月

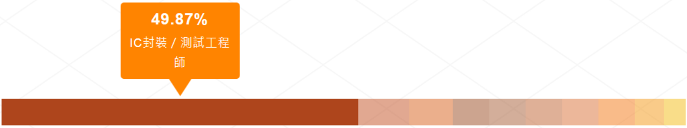


晉升為管理階級或為更高階的主管的人

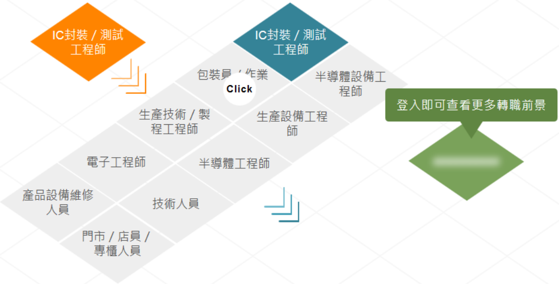
10.15%

轉職職務分析

IC封裝 / 測試工程師求職者的下一份工作選擇職務比例



請選擇IC封裝 / 測試工程師的下一份工作看未來發展前景



請選擇您的求職狀態

我想要轉職 ›

‹ 我是社會新鮮人

意見反應 ›

工作甘苦談

更多工作甘苦談 ›

封裝產品工程師

工作內涵：封裝產品工程師基本的工作是規劃產品製造流程，並提出改善的方案(如：縮短生產製造時間、降低製造成本等)，確保產品生產...

工作甘苦談 | 封裝產品工程師 | 光電半導體

職務類別：光電半導體　　職稱：封裝產品工程師

封裝產品工程師

適合產業：半導體封裝及測試業(2613)、電子零組件製造業(26)、電腦、電子產品及光學製品(27) 工作內涵：封裝產品工程師基本的工作...

工作甘苦談 | 封裝產品工程師 | 光電半導體

職務類別：光電半導體　　職稱：封裝產品工程師

轉職 — 下個工作會更好?!

轉職是必然的嗎？轉職換工作是上班族不可避免的事情，不論是換公司或是換職位!只是這件事在同事間，好像有點隱諱，大概是我們的職...

工作甘苦談 | 產品測試工程 | 光電半導體

職務類別：光電半導體　　職稱：產品測試工程

第一次在科技業上班

在高中畢業後，好不容易考上國立科大，在電子工程學系沒日沒夜的認真學習四年後，終於快到了鳳凰花開的季節了。在失業率屢破新高的...

工作甘苦談 | 產品工程師 | 光電半導體

職務類別：光電半導體　　職稱：產品工程師

助理工程師的日子

在電子工程科學習了兩年多的時間 ，當完兵之後就開始找尋工作又遇到了經濟不景氣 ，失業率很高的時代 ，又遇上了畢業潮的衝擊現在...

重視員工價值，打造優質環境

台灣半導體產業已經走到末路?!近幾年，力旺電子年年都有兩位數成長，總經理沈士傑以力旺電子發揮核心技術、加以商品化的歷程，指...

工作甘苦談 | 助理工程師 | 光電半導體
職務類別：光電半導體　職稱：助理工程師

工作甘苦談 | 工程師 | 光電半導體 | 影音
職務類別：光電半導體　職稱：工程師

熱門職缺

更多熱門職缺 ›

封裝製程工程師
面議　3~4年工作經驗
專科
華東科技股份有限公司
高雄市前鎮區

作業員
面議　1~2年工作經驗
高職
拓寶光電股份有限公司
桃園市龍潭區

早班設備維修工程師
面議　1~2年工作經驗
專科
富吉特半導體股份有限公司
台中市潭子區

測試工程師
面議　3~4年工作經驗
大學
晶焱科技股份有限公司
新竹縣竹北市

封裝工程師(台北)
面議　3~4年工作經驗
大學
晶焱科技股份有限公司
新北市中和區

Account Engineering
面議　2~3年工作經驗
大學
華東科技股份有限公司
高雄市前鎮區

測試工程師
面議　經驗不拘　大學
濶昇系統測試股份有限公司
新竹縣竹東鎮

測試IC助理
面議　經驗不拘
學歷不拘
淳捷電子材料行
台中市南屯區

職涯大師

職務大辭典　薪資公秤　履歷健診　九大職能星　職能地圖
工作甘苦談　落點分析　自傳魔法師　職涯顧問　心靈講座

求職會員服務中心
週一 ~ 週五8:30 ~ 21:00，週六、週日、國定假日9:00 ~ 17:00
電話：(02)8787-1111轉8　傳真：(02)5550-1111
免付費申訴專線：0800-09-1111
E-mail：support@staff.1111.com.tw
下載履歷格式

求才會員服務中心
週一 ~ 週五8:30 ~ 21:00，週六、週日、國定假日9:00 ~ 17:00
苗栗以北-電話：(02)8787-1111　傳真：(02)8787-0578
中部地區-電話：(04)2203-1111　傳真：(04)2206-1111
南部地區-電話：(07)958-1111　傳真：(07)958-2222
E-mail：hr1111@staff.1111.com.tw

全球華人股份有限公司(1111人力銀行) 版權所有© 1111 Job Bank All Rights Reserved.